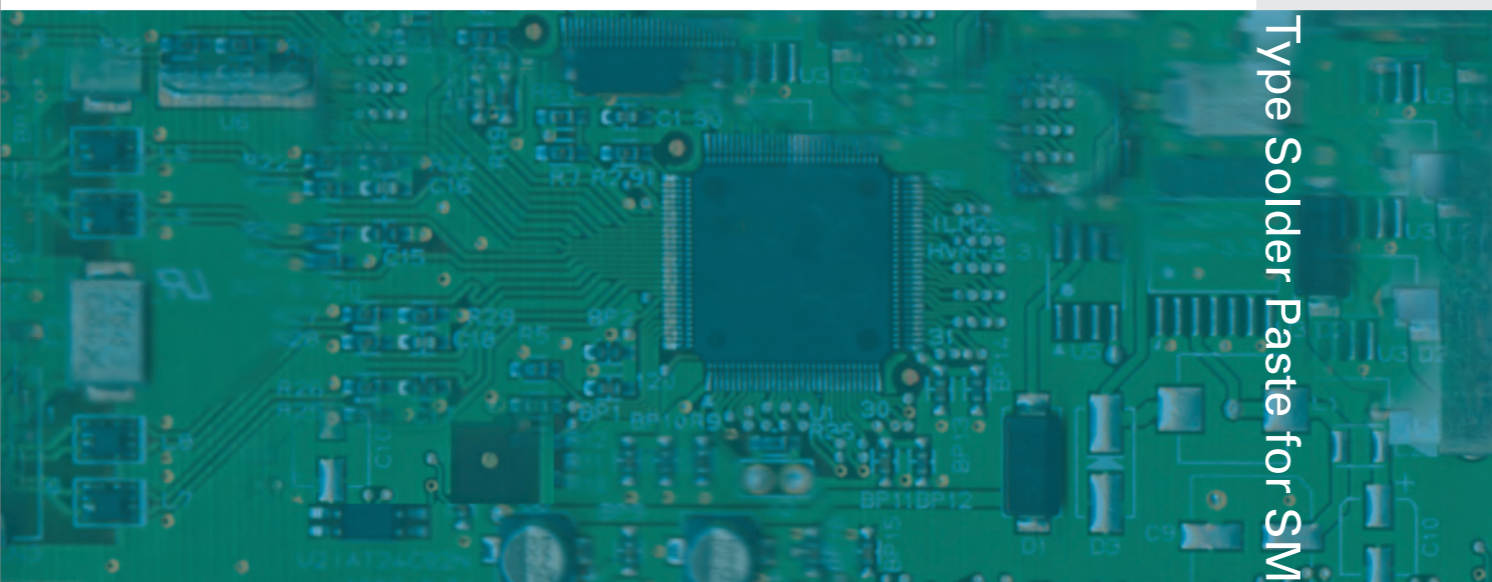


PF305-150TO

SMT用鉛フリーソルダペースト

低ハロゲン・ボイド低減タイプ

- 優れたボイド抑制効果
The excellent reduced void.
- 優れた加熱ダレ防止効果を継承
The excellent avoided heat slumping.



LowHalogen and Reduced Void Type Solder Paste for SMT

● 一般特性 General characteristics

項目 Items	代表特性 Typical Property	試験方法 Test method
合金組成 Alloy composition	Sn-3.0Ag-0.5Cu	-
粒度 Particles Size	20~38 μm	-
フラックス含有量 Flux content	11.5%	JIS Z 3197
ハロゲン含有量 Halide content (chlorine conversion)	0.02%	配合値 Blend Value
銅板腐食試験 Copper plate corrosion test	Pass	JIS Z 3284
クロム酸銀試験 Silver chromate paper test	Pass	JIS Z 3197
銅鏡試験 Copper mirror test	Pass	JIS Z 3197
絶縁抵抗試験 Electric insulation resistance test, SIR	40°C90%RH	3.0 × 10 ¹² Ω
	85°C85%RH	6.1 × 10 ⁹ Ω
100g以上粘着保持時間 Tackiness time of keeping 100g (50kN/m ²) minimum	16 hours	JIS Z 3284
流動特性 Fluidity	粘度 Viscosity	207 Pa·s
	Ti値 Thixotropic index	0.47

上記特性値は代表値で保証値ではありません。The physical property values of above are not the specification of the product.

PF305-150TO

SMT用鉛フリーソルダペースト

低ハロゲン・ボイド低減タイプ

優れたボイド抑制効果
The excellent reduced void

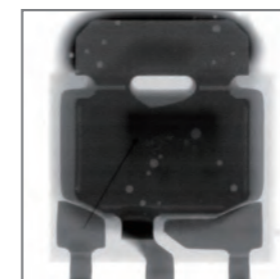
低ハロゲンの定義
Low Halogen

製品中のハロゲン含有量
Halide content of product
塩素 (Cl) < 900 ppm
臭素 (Br) < 900 ppm
合計 Total < 1500 ppm

試験基板 Test board: 銅板 Copper plate
予備加熱 Preheating: 150-190°C 90sec
ピーク温度 Peak temperature: 240°C

パワートランジスタ
Power transistor

PF305-150TO



ボイド率5%

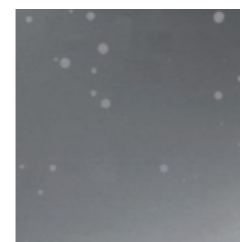
従来品
Conventional product



ボイド率22%

銅チップ
Copper chip

PF305-150TO



ボイド率3%

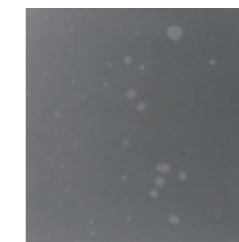
従来品
Conventional product



ボイド率17%

ニッケルチップ
Nickel chip

PF305-150TO



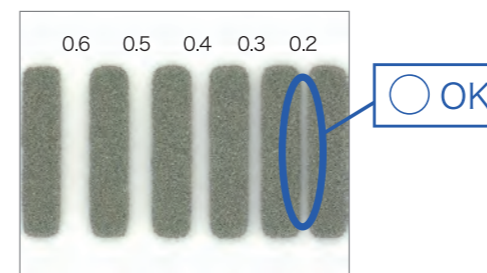
ボイド率2%

従来品
Conventional product



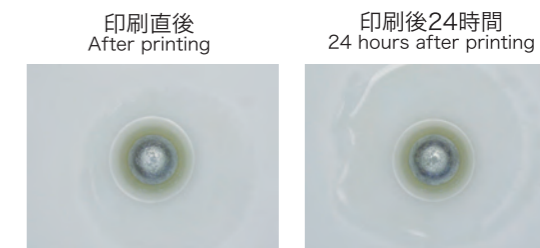
ボイド率20%

優れた加熱ダレ防止効果
The excellent prevented heat slumping



予備加熱ダレ試験 (150°C)
Preheat slumping test
(JIS Z 3284)

優れたはんだボール防止効果
The excellent prevented solder ball



はんだボール発生なし
No solder ball

試験基板 Test board : セラミック板 Ceramics
予備加熱 Preheating: 150°C 60sec
ピーク温度 Peak temperature: 260°C
(JIS Z 3284)

LowHalogen and Reduced Void Type Solder Paste for SMT PF305-150TO